

# 金锡焊球 Au80Sn20锡球 半导体封装植球 激光植球 0.05 ~ 1.0mm

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 金锡焊球 Au80Sn20锡球 半导体封装植球<br>激光植球 0.05 ~ 1.0mm |
| 公司名称 | 海普半导体（洛阳）有限公司                                |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 | 品牌:海普  |
| 公司地址 | 河南省洛阳市宜阳县锦屏镇产业集聚区电子电器<br>工业园1号               |
| 联系电话 | 18530006115 18530006115                      |

## 产品详情

海普半导体（洛阳）有限公司是一家集研发、生产运营、销售服务为一体的高科技企业，业务范围包括：金属合金制品、电子和半导体材料及设备的生产与销售,焊接材料及设备的生产及销售，电子产品及设备的加工组装和销售，主要产品有：BGA锡球（SAC305无铅锡球、Sn63Pb37有铅锡球、Pb90Sn10高铅锡球、金锡焊球、编带锡球；熔点120-350 任意温度定制；0.05-1.8mm任意尺寸定制）、铜核球（镀锡铜核球、镀金铜核球）、CCGA焊柱（Pb90Sn10高铅焊柱、缠绕铜带增强螺旋焊柱、微弹簧焊柱）、铜柱、倒装/植球助焊剂flux、预成型焊料、金锡焊片、金锡盖板、焊锡膏、电镀锡球等，提供BGA植球CCGA植柱代加工服务，提供封装整体解决方案，代理各类半导体封装设备